

**(19) 대한민국특허청(KR)**  
**(12) 공개특허공보(A)**

|   |  |
|---|--|
| (51) Int. Cl. <sup>6</sup><br><u>A01M 13/00</u> | (11) 공개번호      특 1995-0002582<br>(43) 공개일자      1995년02월16일                    |
| (21) 출원번호      특 1994-0018505                   |  |
| (22) 출원일자      1994년07월28일                      |  |
| (30) 우선권주장                                      | 93-187965 1993년07월29일 일본(JP)<br>94-063027 1994년03월31일 일본(JP)                   |
| (71) 출원인  | 스미또모 가가꾸 고오교 가부시끼가이샤      고사이 아끼오<br>일본국 오오사까시 츠오꾸 기따하마 4쪼메 5방 33고             |
| (72) 발명자  | 우에다 미노루<br>일본국 오오사까후 도요나까시 우에노니시 2-13-33<br>오까다 겐야<br>일본국 효고겐 다까라즈까시 메후 2-14-7 |
| (74) 대리인  | 이준구, 박해선   |

**심사청구 : 없음****(54) 약제의 가열 증발 테이프 및 약제의 가열 증발법****요약**

약제를 실질적으로 함유하지 않는 기재층의 한 면에 약제를 함유하는 도료를 적용하여 형성된 약제를 함유하는 도막층 및 약제를 실질적으로 함유하지 않는 기재층에 관한 것이다. 또한 본 발명은 테이프를 발열체 상에 테이프 기재층의 비도포층을 발열체와 접촉케 하면서 이동시킴을 특징으로 하는 가열 증발 방법에 관한 것이다.

**대표도****도1****형세서**

## [발명의 명칭]

약제의 가열 증발 테이프 및 약제의 가열 증발법

## [도면의 간단한 설명]

제 1 도는 본 발명의 가열 증발법에 사용되는 장치를 나타내는 사시도이다, 제 2 도는 사용되는 제 1 도의 장치를 나타내는 사시도이다, 제 3 도는 본 발명의 가열 증발법에 사용되는 다른 장치를 나타내는 사시도이다.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

**(57) 청구의 범위****청구항 1**

약제를 실질적으로 함유하지 않는 기재층의 한 면에, 약제를 함유하는 도료를 적용하여 형성된 가열증발 가능한 약제를 함유하는 도막층 및 약제를 실질적으로 함유하지 않는 기재층을 함유하는 테이프.

**청구항 2**

제 1 항에 있어서, 도료는 유성 페인트, 섬유성 도료, 합성 수지 애나멜 및 와니스, 및 플루오로폴리머 수지 애나멜 및 오니스로부터 선택되고; 가열 증발 가능한 약제는 가열가능한 살충제, 살균제, 살곰팡이제 및 방향제로부터 선택되며 ; 기재층은 유리섬유로 강화될 수도 있는 합성수지, 알루미늄 호일 또는 알루미늄 적층 필름으로 만들어진 테이프.

**청구항 3**

제 2 항에 있어서, 유성 페인트는 보일유, 유성 와니스 또는 정와니스로부터 선택되고; 섬유성 도료는 셀룰로스계 애나멜, 와니스 또는 수지로부터 선택되고; 합성수지 애나멜 및 와니스는 패놀계 수지 애나

멜 및 와니스, 알카드 수지 에나멜 및 와니스, 비닐 수지 에나멜 및 와니스, 에폭시 수지 에나멜 및 와니스, 아크릴산 수지 에나멜, 불포화 폴리에스테르 수지 에나멜 및 와니스, 폴리우레탄 수지 에나멜 및 와니스, 실리콘 수지 에나멜 및 와니스로부터 선택되고 ; 기재층을 만드는데 사용되는 합성 수지는 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 폴리플루오로에틸렌, 폴리아미드 또는 폴리아미드로부터 선택되는 테이프.

#### 청구항 4

제 2 항에 있어서, 도료는 셀룰로스계 수지 에나멜 및 와니스 및 폴리우레탄 수지 에나멜 및 와니스로부터 선택되는 테이프.

#### 청구항 5

제 2 항에 있어서, 약제는 살충제 또는 살곰팡이제인 테이프.

#### 청구항 6

제 2 항에 있어서, 약제는 피레트로이드 화합물, 유기인 화합물, 카르바메이트 화합물 또는 아릴아졸 화합물인 테이프.

#### 청구항 7

제 2 항에 있어서, 약제는 피레트로이드 화합물인 테이프.

#### 청구항 8

제 2 항에 있어서, 약제는 알레트린, 프랄레트린, 푸라메트린, 퍼메트린 또는 벤플루트린인 테이프.

#### 청구항 9

약제를 실질적으로 함유하지 않는 기재층의 한 면에, 약제를 함유하는 도료를 적용하여 형성된 가열가능한 약제를 함유하는 도막층 및 약제를 실질적으로 함유하지 않는 기재층을 함유하는 테이프를 테이프 기재층의 비도포층을 발열체와 접촉케 하면서 발열체 상에 이동시킴을 특징으로 하는 약제의 가열 증발 방법.

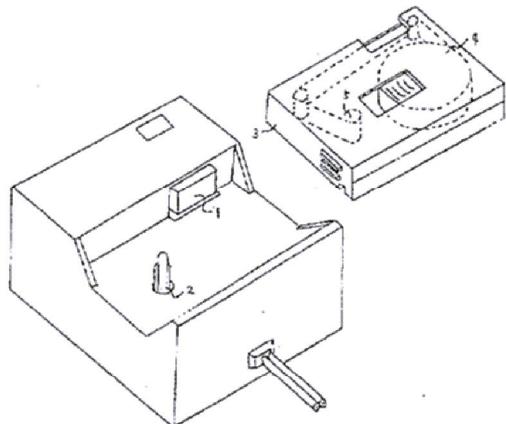
#### 청구항 10

약제를 실질적으로 함유하지 않는 기재층의 한 면에, 살충제, 살균제 또는 살곰팡이제를 함유하는 도료를 적용하여 형성된 살충제, 살균제 또는 살곰팡이제를 함유하는 도막층 및 약제를 실질적으로 함유하지 않는 기재층을 함유하는 테이프를 테이프 기재층의 비도포층을 발열체와 접촉케 하면서 발열체 상에 이동시킴으로써 가열 증발 가능한 살충제, 살균제 또는 살곰팡이제의 증발을 특징으로 하는 해충 방제법.

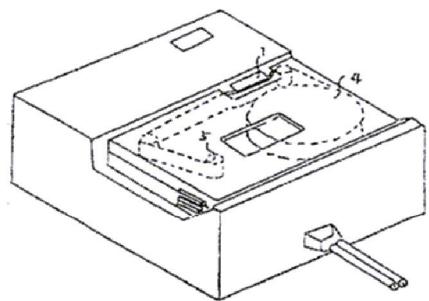
※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

#### 도면

##### 도면1



도면2



도면3

